



VIA Technologies, Inc.

531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | www.viatech.com

**VIA、Qualcomm® Snapdragon™ 820E エンベデッドプラットフォームを搭載した
VIA ALTA DS 3 Edge AI システムを発表**
顧客の利便性とエンゲージメントを向上させる新しい小売りアプリケーション向け
インテリジェントエッジデバイスの開発と展開を加速

2018 年 9 月 26 日 台湾・新北市 – VIA Technologies, Inc.は、現地時間の 9 月 25 日、VIA ALTA DS 3 Edge AI システムを発表しました。Qualcomm® Snapdragon™ 820E エンベデッドプラットフォームを搭載した本システムは、リアルタイムの画像およびビデオのキャプチャ、処理および表示機能を必要とするインテリジェントなサイネージ、キオスクおよびアクセス制御デバイスの迅速な開発と展開を可能にします。

VIA ALTA DS 3 は、Qualcomm Snapdragon 820E エンベデッドプラットフォームが有する最先端のコンピューティング、グラフィックス、AI 処理機能を活用し、お客様が独自の AI アプリケーションと没入感あるマルチメディアサイネージ表示を組み合わせることで、新しいユーザーエクスペリエンスをコンパクトかつ低消費電力のシステムとして実現可能です。



また、デュアルディスプレイへのミラー表示と独立したビデオ再生モードを含むデュアル 4K ディスプレイサポートに加え、ギガビットイーサネットポートや Wi-Fi&Bluetooth 4.1、4G LTE ワイヤレス統合オプションなどの豊富なネットワーク接続性も提供します。耐久性にすぐれた小型ケースには、3 つの USB 3.0 ポート、ミニ USB 2.0 ポート、miniPCIe スロットを備えるほか、柔軟なカメラサポートや I/O 周辺機器の拡

Press Release

VIA、Qualcomm® Snapdragon™ 820E エンベデッドプラットフォームを搭載した VIA ALTA DS 3 Edge AI システムを発表

2/3

張性も提供されます。さらに 4GB の POP LPDDR4 メモリ、16GB の eMMC フラッシュメモリ、M.2 スロット、SD カードスロット、ライン出力とマイク入力のオーディオジャックも備えます。

VIA ALTA DS 3 には、ソフトウェアと AI アプリケーションの開発を容易にするため、CPU、GPU または DSP を使用して、Caffe / Caffe2、ONNX または TensorFlow でトレーニングされた 1 つ以上のニューラルネットワークモデルを開発者が実行できるように設計された AI 向けの Qualcomm Neural Processing SDK を含む Android 8.0 を搭載した BSP が付属しています

VIA Technologies, Inc.の国際マーケティング担当 VP リチャード・ブラウンは、次のように述べています。「VIA ALTA DS 3 は、顧客の利便性とエンゲージメントを向上させる充実したマルチメディア機能を備えた新しい小売り向けアプリケーションの革新を加速する統合システムプラットフォームを提供します。フレキシブルなハードウェアとソフトウェアのカスタマイズオプションにより、システムは、正確なエッジ AI 導入要件を満たすように最適化され、将来の拡張に必要なスケーラビリティを提供します」

VIA ALTA DS 3 の入手性

VIA ALTA DS 3 は世界中に出荷可能です。システムサンプルは、下記オンラインショップで 399 米ドル+送料で注文可能です。

<https://www.viaembeddedstore.com/shop/systems/alta-ds-3/>

詳細については、こちらをご覧ください：

<https://www.viatech.com/en/systems/android-signage-players/alta-ds-3/>

本リリースに関連する画像については、<https://www.viagallery.com/alta-ds-3/> をご参照ください。

VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc.は、高度に統合された組み込み用プラットフォームと、ビデオウォールやデジタル看板からヘルスケアや企業オートメーションまでにわたる M2M、IoT、そしてスマートシティアプリケーションの開発において国際的に主導的な役割を果たしています。本社を台湾・台北におき、VIA の国際的なネットワークはアメリカ、ヨーロッパ、そしてアジアのハイテクセンターを結び、顧客層は世界中の最先端のハイテク、通信、家電にまでわたっています。詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.viatech.com/>

お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: mktjp@viatech.co.jp

VIA、Qualcomm® Snapdragon™ 820E エンベデッドプラットフォームを搭載した VIA ALTA DS 3 Edge AI システムを発表

3/3

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown (VIA Technologies, Inc. 国際マーケティング担当 VP)

メールアドレス : RIBrown@via.com.tw

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス : press@hanare-pr.jp

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。

Qualcomm Incorporated の子会社 Qualcomm Technologies, Inc. の製品である Qualcomm® Snapdragon™ 820 Embedded Platform を搭載しています。

Qualcomm, Snapdragon, Kryo, Adreno, および Hexagon は、米国およびその他の国における Qualcomm Incorporated の商標です。Qualcomm Spectra は、Qualcomm Incorporated の商標です。

Qualcomm Snapdragon, Qualcomm Kryo, Qualcomm Adreno, Qualcomm Hexagon, および Qualcomm Spectra は、Qualcomm Technologies, Inc. の製品です。

本リリースに記載されている実際の企業および製品名は、それぞれの所有者の商標です。